证券代码：688456 证券简称：有研粉材

**有研粉末新材料股份有限公司**

**投资者关系活动记录表（2024年12月3日）**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □电话会议  □其他 |
| 参与单位名称 | 中信证券、中邮创业基金、星石投资、天壹资本 |
| 会议时间 | 2024年12月3日9：30-10：30 |
| 会议地点 | 有研大厦 |
| 上市公司接待人员 | 董事会秘书、财务总监、总法律顾问：姜珊  证券事务代表：王妍  证券事务专员：瓮佳星 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | Q1：请简要介绍公司今年的整体经营情况。  A1：公司前三季度整体销量23,000吨，同比增长10%，营业收入23亿元，同比增长18%，其中销量增长带来的增量是11%，由于原材料价格上涨带来的增量是7%。利润总额4,489万元，同比增长3%。四季度市场开拓效果良好，11月公司铜粉销量再创新高，有研合肥、有研重冶、英国Markin公司均创造了本公司有史以来单月销量的最高记录。  Q2：请简要介绍公司近期有重大突破的新产品的开发情况。A2：铜基板块目前实现突破的新产品主要为导热铜粉，主要用于制造风冷散热组件，与传统雾化铜粉相比，具有梯度孔隙结构、比表面积发达、松装密度低等特点。此款铜粉在散热效率方面较传统雾化铜粉，性能提升 10%-20%，热端收益3-5℃，属于行业内比较大的进步。  Q3：导热铜粉具体市面上的应用有哪些？  A3：该产品是公司与某终端用户合作开发的产品，现已成功应用于部分GPU散热器件。据了解该产品目前也已部分应用于AI算力服务器、基站、大型路由器、交换机等场景，应用效果截至目前反馈良好。  Q4：导热铜粉的下游需求目前如何？  A4：目前已经实现每月吨级供货，供应稳定。该产品在其他领域的应用也在测试阶段，下游需求根据公司研发进度有望进一步扩大，公司的柔性产线使得现有产能能够迅速匹配市场需求。  Q5：行业内只有我们能生产导热铜粉吗？ 该技术短期内是否容易被竞争对手突破？  A5：目前只有公司能生产新型导热铜粉。公司经过多年发展，在长期研发积累的大量实验数据、工艺经验基础上，形成了完善的研发技术体系，拥有国家级创新平台，材料研发团队可以参与到客户的设计端，共同设计、开发需要的粉体材料，定制适合于下游客户应用的粉体产品。本次新产品研发就起源于下游客户的应用需求，共同研发了两年，在加工方式上实现了突破，解决了以新的生产方式制造的导热铜粉在产品应用上的问题，在行业内属于首创。  Q6：公司产品还有哪些其他亮点？  A6：公司未来研发方向是向新的应用领域拓展、延伸，也会继续延伸产业链，如铜基板块，在保持现有市占率前提下，加强新产品的研发力度，如复合铜粉、超细铜粉、低松比铜粉等高附加值产品。如电子浆料领域，专注于超细镍粉、超细铜粉、超细银粉、银包铜粉及其浆料等新产品的研发，增加互连材料的种类，可应用于PCB、MLCC等产品。结合国家设备更新、发展新质生产力的政策，不断调整产品结构，开发新的应用领域，形成新的产业链，扩大市场需求。  Q7：铜粉产品的定价方式是怎样的？  A7：公司铜基板块产品的定价方式主要是原材料+加工费的模式。  Q8：关注到3D打印产品的毛利水平达40%，今年的出货量预计如何？  A8：本年3D打印粉体销量整体向好，截至十月，公司3D打印粉体销售量达到2023年全年销售量的2倍，预计年底可以达到3倍。  Q9：增材这块有涉及消费电子？  A9：增材板块不涉及消费电子行业，公司的锡基板块下游行业为消费电子行业。  Q10：公司在光伏领域有没有铜浆的应用？  A10：公司在几年前参加过科技部的国际合作项目、北京市重点研发计划，有对铜浆的应用研究，当时主要应用于三代半导体。有了这样的技术积累，今后铜浆研发应用于哪些场景，主要考虑市场的应用成本，高温银浆和低温银浆技术路线不同，银包铜替代的有可能以高温银浆为主，银包铜场景的异质结、IBC等低温银浆，铜浆在粉体、载体部分都会有技术区别，公司也在关注并紧跟市场技术路线，等待市场批量化使用的行业信号。  Q11：公司对各板块未来发展如何规划。  A11：公司铜基板块经过多年的发展，在国内市占率方面已取得显著优势，未来公司会继续加强新产品的研发力度，如研发复合铜粉、超细铜粉、低松比铜粉、导热铜粉等产品，未来会做好产品细分，根据市场需求灵活调整产品结构。目前公司锡基板块的产能能够满足市场需求，板块整体的发展致力于技术迭代并向下游新兴产业链延伸，同时公司通过调整产业结构，生产附加值更高的产品，争取达到20%-30%的年增长率。公司对增材板块寄予厚望，依托科创中心的募投项目，对3D打印板块进行大规模投入，未来会逐步推进向下游的延伸发展。同时在提高3D打印粉末制备能力上持续加劲，预计明年会实现量产的重大突破。电子浆料板块还处于技术研发阶段，主要聚焦国家任务，属于未来产业。公司之后将继续融入国家战略，保障产业链供应链安全稳定，加快传统产业转型，打造战略性新兴产业，在中国式现代化建设中展现央企责任担当，以更加优异的业绩回报广大投资者。 |
| 关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明 | 不涉及 |
| 附件清单（如有） |  |
| 日期 | 2024年12月9日 |